

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
配当金支払株主確定日	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所市場第一部
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご紹介

最新のトピックスをはじめ、財務情報や会社情報を掲載しております。製品・アプリケーションの紹介や広報誌「samco NOW」など、掲載内容を充実させております。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。

<https://www.samco.co.jp/>



トップページ

samco

40th
Anniversary

samco
サムコ株式会社

証券コード 6387

BUSINESS REPORT 2019

第40期 年次報告書
2018.08.01 ▶ 2019.07.31





令和元年10月
左：代表取締役社長兼COO 川邊 史
右：代表取締役会長兼CEO 辻 理

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

当社第40期（平成30年8月1日～令和元年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

当期（第40期）の事業環境と経営成績

当期、当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、当社の関わる化合物半導体および電子部品製造装置の販売マーケットにおいて、新たなモバイル機器や車載センサーなどの電子部品分野、あるいはMEMS（Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子）といった先端分野での研究開発投資が幅広い企業で進み、その中から本格生産への移行も進んでおります。

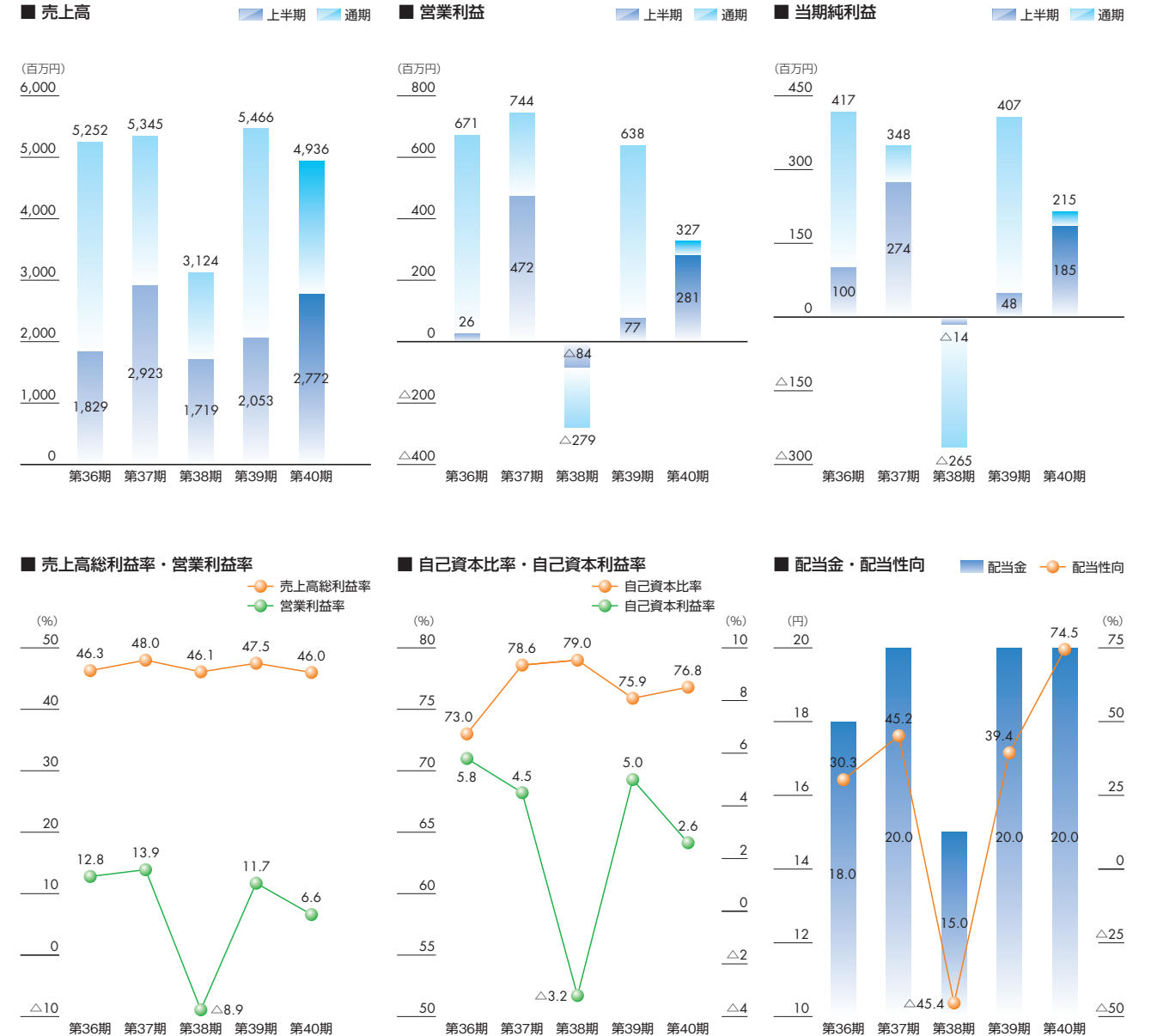
このような状況の下、前期（平成30年7月期）に引き続き、オプトエレクトロニクス分野の通信用レーザーや、電子部品分野の高周波デバイス、パワーデバイス、MEMS、各種センサー等向け製造装置の受注活動、新製品の拡販に注力してまいりました。しかしながら、スマートフォン市場の需要低迷および米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速が、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資判断に影響していることにより、受注高は伸び悩みの傾向が続きました。その結果、国内売上高は3,161百万円（前期比1.9%減）、輸出販売高は1,774百万円（前期比20.9%減）となりました。

以上の結果、当期における業績は、売上高が4,936百万円（前期比9.7%減）、営業利益は327百万円（前期比48.6%減）、経常利益は305百万円（前期比52.5%減）、当期純利益は215百万円（前期比47.1%減）となりました。

第41期の見通し

当期末の受注残高は2,077百万円（前期比2.8%増）であり、オプトエレクトロニクス分野では通信系レーザー用途、電子部品分野ではパワーデバイス、各種センサー用途等で商談が進んでおります。また、実装・表面処理分野では引き続きアクアプラズマを重点製品として販売活動を推進しております。

以上の取り組みにより、第41期の売上高は6,200百万円（前期比25.6%増）、営業利益は750百万円（前期比128.8%増）、経常利益は720百万円（前期比136.0%増）、当期純利益は490百万円（前期比127.3%増）となる見込みであります。

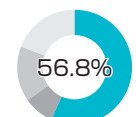


品目別販売状況

エッチング装置

売上高 2,801百万円

前期比 15.9%減



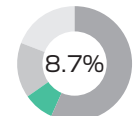
当期売上高構成比

電子部品分野のセンサー向けとパワーデバイス向けの販売が拡大した一方で高周波フィルタ向けの販売が落ち込み、売上高は2,801百万円となりました。

CVD装置

売上高 429百万円

前期比 52.5%減



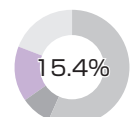
当期売上高構成比

前期に好調であったオプトエレクトロニクス分野の生産用のLD向けの販売が振るわず、売上高は429百万円となりました。

洗浄装置

売上高 762百万円

前期比 52.0%増



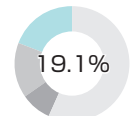
当期売上高構成比

オプトエレクトロニクス分野の生産用のLD向けと電子部品分野の生産用のパワーデバイス向けの好調により、売上高は762百万円となりました。

その他

売上高 942百万円

前期比 29.5%増



当期売上高構成比

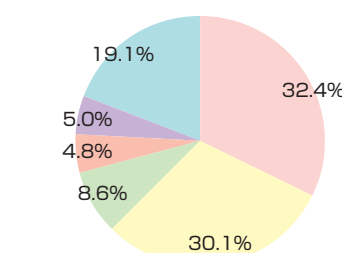
既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造作業などで、売上高は942百万円となりました。

売上高割合状況

売上高 4,936百万円

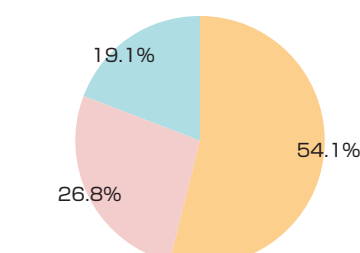
前期比 9.7%減

用途別売上高割合



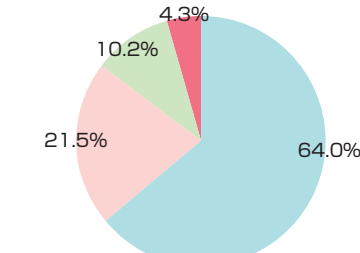
- 電子部品分野
- オプトエレクトロニクス分野
- シリコン分野
- 実装・表面処理分野
- その他分野
- 部品・メンテナンス

目的別売上高割合



- 生産用
- 研究開発用
- 部品・メンテナンス

地域別売上高割合



- 国内
- アジア
- 北米
- 欧州

サムコの製品

エッチング装置



ICPエッチング装置

半導体の加工を得意としており、次世代パワーデバイスの材料である窒化ガリウム (GaN) や炭化シリコン (SiC) などの加工が可能です。

微細加工分野

CVD装置



液体ソースCVD®装置

反応性の気体を半導体基板上に供給し、プラズマなどで化学反応させることで薄い膜を堆積させる装置です。半導体を水分やほこりから保護したり、絶縁性を持たせたりする目的で使用されます。当社は独自の原料を用いた液体ソースCVD® (Chemical Vapor Deposition=化学気相成長) 法に特長があり、比較的低温での高速成膜が可能です。

薄膜形成分野

洗浄装置



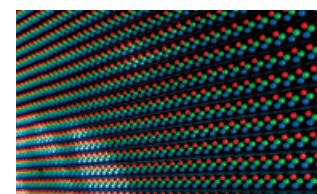
プラズマクリーナー

液体を用いないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて半導体基板の表面を洗浄します。独自に開発したAqua Plasma®は銀や銅の表面還元や樹脂の接合など幅広い分野に応用されています。また、紫外線 (UV) とオゾン (O₃) を用いたUVオゾンクリーナーも取り揃えています。

洗浄・表面処理分野

サムコの事業分野

オプトエレクトロニクス分野



照明や光通信に使われるLEDやLDなどの発光デバイス

電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりするデバイスで、主に化合物半導体で作られています。自動車のヘッドライトに用いられる高輝度LEDやLD、データセンターで用いられる近距離通信用のLDや光導波路などのデバイスがあります。



電子部品分野



IoT (Internet of Things) を支えるキーデバイス

各種センサー・MEMS (Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子)・高周波フィルタなどの分野です。スマートフォンに多数搭載される高周波フィルタは、IoT時代を迎えその応用製品が飛躍的に増加しています。



実装・表面処理分野



電子機器の小型化、軽量化および高機能化を実現する重要なプロセス

パッケージ工程前のドライ洗浄分野です。最先端パッケージとして注目が高まるファンアウトウエハーレベルパッケージ (FOWLP) をはじめ、高機能な電子機器を製造するための信頼性の高い洗浄が要求されます。



貸借対照表

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (令和元年7月31日現在)	前期 (平成30年7月31日現在)	科目	当期 (令和元年7月31日現在)	前期 (平成30年7月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	7,284,619	7,314,730	流動負債	1,678,271	1,817,839
現金及び預金	4,807,657	4,201,150	買掛金	493,182	547,843
受取手形	36,720	91,768	短期借入金	700,000	700,000
電子記録債権	98,900	555,554	未払金	107,824	105,448
売掛金	1,195,426	1,546,348	未払費用	32,497	32,442
たな卸資産	1,095,232	842,529	未払法人税等	17,901	160,532
その他	50,819	77,601	前受金	222,559	157,730
貸倒引当金	△138	△222	預り金	29,307	47,250
固定資産	3,499,439	3,593,746	賞与引当金	24,600	24,400
有形固定資産	3,035,084	3,065,870	役員賞与引当金	3,106	9,672
建物	332,387	364,172	製品保証引当金	25,700	23,500
構築物	898	1,143	その他の他	21,592	9,018
機械及び装置	76,102	79,625	固定負債	824,848	812,498
車両運搬具	12,221	8,164	退職給付引当金	428,374	420,441
工具、器具及び備品	22,929	25,191	役員退職慰労引当金	377,456	368,040
土地	2,530,836	2,530,836	その他の他	19,017	24,016
リース資産	16,085	23,130	負債合計	2,503,119	2,630,337
建設仮勘定	43,623	33,606	(純資産の部)		
無形固定資産	15,999	13,985	株主資本	8,220,347	8,165,462
投資その他の資産	448,355	513,890	資本金	1,663,687	1,663,687
投資有価証券	147,971	217,839	資本剰余金	2,079,487	2,079,487
関係会社株式	25,207	25,207	資本準備金	2,079,487	2,079,487
繰延税金資産	130,268	124,860	利益剰余金	4,487,976	4,433,025
その他	144,907	145,983	利益準備金	59,500	59,500
資産合計	10,784,058	10,908,476	その他利益剰余金	4,428,476	4,373,525
			別途積立金	3,867,000	3,867,000
			繰越利益剰余金	561,476	506,525
			自己株式	△10,803	△10,737
			評価・換算差額等	60,591	112,676
			その他有価証券評価差額金	60,591	112,676
			純資産合計	8,280,939	8,278,139
			負債・純資産合計	10,784,058	10,908,476

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自平成30年8月1日 至令和元年7月31日)	前期 (自平成29年8月1日 至平成30年7月31日)
売上高	4,936,132	5,466,483
売上原価	2,665,630	2,870,429
売上総利益	2,270,501	2,596,054
販売費及び一般管理費	1,942,752	1,957,799
営業利益	327,749	638,254
営業外収益	23,858	15,862
営業外費用	46,499	11,366
経常利益	305,108	642,751
特別損失	—	78,811
税引前当期純利益	305,108	563,939
法人税、住民税及び事業税	72,009	134,690
法人税等調整額	17,481	21,329
当期純利益	215,617	407,919

Point ▶ 売上高

スマートフォン市場の需要低迷及び米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速を背景に、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資意欲が低下。売上高は前期比9.7%減の4,936,132千円。

国内の売上高は、前期比1.9%減の3,161,327千円。
海外の売上高は、前期比20.9%減の1,774,805千円。

Point ▶ 販売費及び一般管理費

賞与、試験研究費等の減少により前期比0.8%減の1,942,752千円となったが、販管費率は前期の35.8%から39.4%へ3.6ポイント増加。

Point ▶ 営業外費用

前期は円高による為替差損が7,094千円発生、当期は円高がさらに進行し、為替差損は41,296千円へ拡大。

Point ▶ 損益分岐点

損益分岐点売上高は4,222,421千円。

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自平成30年8月1日 至令和元年7月31日)	前期 (自平成29年8月1日 至平成30年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	857,760	△223,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	△396,899	23,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△171,176	△228,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	△22,585	△3,296
現金及び現金同等物の増減額	267,098	△432,212
現金及び現金同等物の期首残高	2,486,070	2,918,283
現金及び現金同等物の期末残高	2,753,168	2,486,070

Point ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：売上債権の減少862,622千円、税引前当期純利益305,108千円、減価償却費92,716千円、前受金の増加64,828千円。
マイナス要因：たな卸資産の増加239,148千円、法人税等の支払202,474千円、仕入債務の減少54,660千円、預り金の減少17,943千円。

Point ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：定期預金の払戻による収入3,047,914千円、貸付金の回収による収入58,542千円。
マイナス要因：定期預金の預入による支出3,398,147千円、有形固定資産の取得による支出69,896千円、貸付けによる支出33,522千円。

Point ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー

マイナス要因：配当金の支払160,667千円、リース債務の返済による支出10,443千円。

中期経営計画

当社は、化合物半導体および電子部品製造用の製造装置を主力製品とし、研究開発機市場と生産機市場それぞれで事業を展開しております。当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という経営理念のもと、研究開発型企業として成長してきた高度な技術力を維持すると同時に、蓄積した技術を生産機市場で活かすことで、事業規模の拡大を図っております。加えて、当社のコアテクノロジーである「薄膜技術」は医療、バイオ、環境といったライフサイエンスおよびエネルギー分野に活かすことが可能であり、中期的には当社の新規事業、新分野として成長させることを目指しております。

当社の主たる事業領域である化合物半導体および電子部品製造装置のマーケットでは、世の中に存在する様々なモノがネットワークと繋がるIoT（モノのインターネット）、自動運転、ロボット、AI（人工知能）等の技術革新の時代が本格的な幕開けを迎えつつあり、関連企業は設備投資に対して前向きな姿勢を示しております。令和元年8月よりスタートさせた中期経営計画において、当社の新たな成長に向けた中長期ビジョンを作成し、以下の課題に取り組んでおります。

課題

1. 海外販売の拡大

当社の事業を成長軌道に乗せるため、海外販売の拡大を最大の目標に掲げ、将来の成長期待の高い海外への事業展開を積極的に行っております。海外拠点、販売・サービス体制の整備と充実を図り、引き続き海外市場の開拓を図っていく方針であります。台湾、中国、韓国の既存主要顧客との繋がりを維持、強化しながら、北米、欧州、インド等の新たなマーケットの確立により、当面は海外売上高比率50%以上の達成を目指してまいります。

2. 成膜装置販売の拡大

当社の属する半導体等電子部品製造装置市場は、常に技術開発の競争、顧客ニーズの多様化や高度化、グローバル化が加速しており、継続的な研究開発活動による高付加価値・高機能製品の開発、新製品の市場投入を進めることで、市場での競争力を維持し続けることが命題であります。

近年では、ドライエッチング装置のRIE-200iPNや、洗浄装置のアクアプラズマクリーナーの新製品を開発、販売をしておりますが、今後は既存の製品群の中から、特に成膜装置（CVD装置、ALD装置等）の販売拡大を目的とした施策を行ってまいります。顧客ニーズに合わせた新製品の開発、成膜装置の性能向上による競争力の強化、製品ラインナップの見直し、本社研究開発センターのデモ拠点の整備等の施策を図ってまいります。

3. 新規事業の立上げ

現在の製品群であるCVD装置、エッチング装置、洗浄装置を新たな事業領域へ展開し、新規事業として業績への寄与を目指しております。具体的には、第38期よりヘルスケア分野へ進出し、医療分野における滅菌装置の開発および医療計測分野におけるヘルスケアチップの加工装置の開発・販売を行っております。

また、新たなマーケット開拓のため、本社研究開発センター、米国オプトフィルムズ研究所での研究開発、国内外の大学や各種クラスターとの共同研究の継続により、薄膜事業に関連する新規事業を創出し、成長を加速させてまいります。

以上の課題を克服し、第41期は売上高6,200百万円、第42期は7,400百万円、第43期は7,800百万円という中期経営計画の目標達成を目指します。

○国内外の展示会に積極的に出展

当社は世界各地のセミコンショーやオプトエレクトロニクス分野などの展示会にほぼ毎月出展しております。2019年7月期下期には、セミコンショーでは3月に上海で開催されました『SEMICON China 2019』、5月にマレーシアのクアラルンプールで開催されました『SEMICON Southeast Asia 2019』、7月にサンフランシスコで開催されました『SEMICON West 2019』に出展いたしました。そのほか、4月に米国ミネアポリスで開催されました『CS Mantech』、5月に奈良で開催されました『化合物半導体週間』といった化合物半導体分野の展示会に出展いたしました。7月には東京で開催されました当社の新規事業分野であるヘルスケア分野の『ファーマラボ』に初出展いたしました。



SEMICON China 2019



SEMICON West 2019

○個人投資家向け会社説明会を開催

去る6月18日、大阪・堺筋本町（ENDO堺筋会議室）で開催されましたマルサントレードIRセミナーにおきまして、当社は個人投資家を対象としました会社説明会を行いました。当社の事業内容や今後の見通し等について代表取締役社長兼COOの川邊史よりご説明いたしました。

○サムコ科学技術振興財団が2019年度 第3回研究助成者5名を決定

サムコ科学技術振興財団は、6月13日に第3回 薄膜技術に関する研究助成の対象者5名を決定いたしました。助成対象者5名には、9月6日に開催されました研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額1,000万円が贈呈されました。式典後には、理化学研究所理事長の松本紘先生（前京都大学総長）による記念講演が行われました。

※研究助成対象者5名とその研究課題につきましては財団のホームページをご覧ください。

<https://www.samco.co.jp/foundation/prize/>



● Office
● Subsidiaries
● Agent

2018 ICPエッチング装置RIE-200iPNを開発。
2016 Aqua Plasma®フリーナーAQ-2000を開発。
2016 マレーシア事務所を開設。
2016 第二生産技術棟を完成。
2014 欧州リヒテンシュタインの洗浄装置メーカーUCP Processing Ltd.を子会社化(samco-ucp AGIに社名変更)。
2014 東京証券取引所市場第一部銘柄へ指定。
2014 東京証券取引所市場第二部へ上場市場を変更。
2013 量産用ICPエッチング装置RIE-600iPC、RIE-800iPBCを開発。
2012 SiCパワーデバイス用ICPエッチング装置RIE-600iPを開発。
2011 シンガポール支店を開設。
2010 アメリカ東部事務所、北京事務所を開設。
2008 韓国事務所、台湾サムコグローバルサービスを開設。
2008 LED量産用ICPエッチング装置RIE-330iPCを開発。
2007 第2研究開発棟を完成。
2006 MEMS用高速Siディープエッチング装置RIE-800iPBを開発。
2004 上海事務所を開設。
2004 株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ株式会社へ社名変更。
2003 化合物半導体デバイス量産用プラズマCVD装置PD-220LCを開発。
2002 生産技術研究棟を完成。
2001 台湾事務所を開設。
2001 日本証券業協会店頭市場(ジャスダック)に上場。
1998 量産用ICPエッチング装置RIE-101iPCを開発。
1997 セミ量産用ICPエッチング装置RIE-200iPを開発。
1996 研究開発用ICPエッチング装置RIE-101iPを開発。
1995 RIE装置RIE-10NRを開発。
1993 東海営業所、つくば営業所を開設。
1991 研究開発センター、第2工場を完成。
1990 液体ソースCVD®装置PD-240Dを開発。
1987 シリコンバレーにオプトフィルムズ研究所を開設。
1985 新社屋完成により、本社を移転。
1984 東京出張所を開設。
1982 マルチチャンバースystem®PDM-303型を開発。
1981 化合物半導体製造用MOCVD装置を開発。
1980 半導体プロセス用大型CVD装置を開発。
1979 株式会社サムコインターナショナル研究所を設立。

化合物半導体デバイス用
ICPエッチング装置
RIE-200iPN

数百台の実績を誇るRIE-200iPNの後継機種として開発した高性能装置。コンパクトな設計のため、省スペースに設置できます。

40年で、
4000台の装置が、
30カ国に納品されました。

創業者の辻理が1979年9月に京都市伏見区のガレージで設立。

■ 会社概要

商号 サムコ株式会社
 英文社名 SAMCO INC.
 設立 昭和54年(1979年)9月
 事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
 資本金 1,663,687,288円
 従業員数 170名
 本社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936
 国内拠点 本社(京都)、東日本営業部(東京)、東海支店(愛知)、つくば営業所(茨城)、福岡営業所(福岡)
 海外拠点 米国(カリフォルニア・ニュージャージー)、台湾、シンガポール、中国(上海・北京)、韓国、マレーシア
 研究拠点 本社研究開発センター(京都)、オプトフィルムズ研究所(米国)

■ 役員

代表取締役会長兼CEO 辻 理
 代表取締役社長兼COO 川 邊 史
 取締役副社長 石川 詞念夫
 取締役常務執行役員 竹之内 聡一郎
 取締役執行役員 山下 晴彦
 社外取締役 村上 正紀
 小林 弘明
 常勤監査役 辻村 茂
 社外監査役 木村 隆之
 西尾 方宏
 執行役員 関 伸修
 久保川 泰彦
 ピーター・ウッド
 本山 慎一
 佐藤 清志

■ 株式の状況

発行可能株式総数 14,400,000株
 発行済株式の総数 8,042,881株
 株主数 7,398名

■ 大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
辻 理	1,005,907	12.5
サムコエンジニアリング(株)	920,282	11.4
㈱サムコ科学技術振興財団	800,000	9.9
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	205,500	2.6
辻 一美	201,465	2.5
サムコ従業員持株会	200,138	2.5
辻 猛	190,015	2.4
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)	160,100	2.0
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
京都中央信用金庫	120,000	1.5

■ 所有者別株式分布状況

